

回路修正サービス

当社では集束イオンビーム加工装置(FIB加工装置)を使用した回路修正サービスを提供しています

- ・デバイスの内部信号を観察したい。
- ・マスク改版前に回路修正内容の有効性を確認したい。
- ・マスク改版を行わないで、特性の違うサンプルを作成したい。

などのご要望に対応いたします。

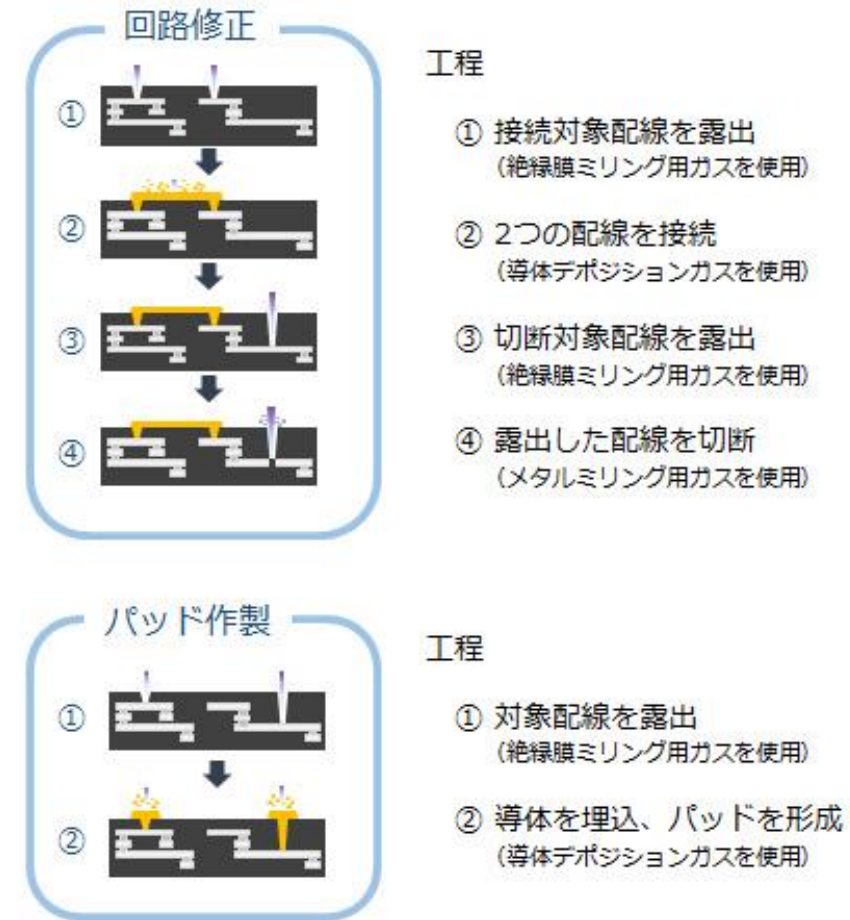
FIB加工装置で出来る事

1. 絶縁膜を削る
2. 配線（アルミ、銅）を削る
3. 導体を成膜する
4. 絶縁膜を成膜する

当社が所有するFIB加工装置は回路修正に特化した仕様となっており、6種類のカスを搭載、加工内容に合わせてカスを使い分けることにより、高速かつ精度よく回路修正を行う事ができます。

その他にも以下に対応しております。


- ・Cu配線、Low-K膜に対応
- ・各種パッケージ、ウェーハー（6，8インチ）、チップ状態での加工に対応
- ・CADデータ（GDS IIフォーマット）を使用した加工位置へのナビゲーション
- ・ICパッケージ開封、ポリイミド剥離などの前処理からFIB加工まで一貫した作業を請け負う事も可能



回路修正サービスのお問い合わせ

回路修正サービスのご相談、ご依頼は下記へお問い合わせください。

TEDS-fa-service@ml.toshiba.co.jp



半導体開発で
真のパートナーとして
信頼される会社をめざします。

TOSHIBA

* 本資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。